

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 26 年 12 月 25 日 (2014.12.25)

【公開番号】特開 2013-213110 (P2013-213110A)

【公開日】平成 25 年 10 月 17 日 (2013.10.17)

【年通号数】公開・登録公報 2013-057

【出願番号】特願 2012-83104 (P2012-83104)

【国際特許分類】

C 0 8 L 23/08 (2006.01)

C 0 8 L 53/02 (2006.01)

C 0 8 L 57/02 (2006.01)

C 0 8 L 23/28 (2006.01)

C 0 8 L 77/00 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 L 23/08

C 0 8 L 53/02

C 0 8 L 57/02

C 0 8 L 23/28

C 0 8 L 77/00

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 11 月 10 日 (2014.11.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

エチレン - 酢酸ビニル共重合体 (樹脂 A)、スチレン - ブタジエン - スチレン共重合体 (樹脂 B)、芳香族系石油樹脂 (樹脂 C)、塩素化ポリオレフィン樹脂 (樹脂 D) および有機溶剤を含有するヒートシール性樹脂組成物であって、

下記 1) ~ 5) であることを特徴とするヒートシール性樹脂組成物。

1) エチレン - 酢酸ビニル共重合体 (樹脂 A) が、

酢酸ビニル含有率 20 ~ 40 重量%

および

メルトマスフローレート 2 ~ 500 g / 10 分

である。

2) 芳香族系石油樹脂 (樹脂 C) が、

軟化点 120 ~ 150

および

重量平均分子量 1,500 ~ 2,500

である。

3) 塩素化ポリオレフィン樹脂 (樹脂 D) が、

塩素含有率 20 ~ 40 重量%

であり、かつ、

無水マレイン酸変性塩素化ポリオレフィン樹脂

である。

4) 樹脂 A、樹脂 B、樹脂 C および樹脂 D が、

固形分重量比率

樹脂 A / 樹脂 B / 樹脂 C / 樹脂 D

= 20 ~ 50 / 15 ~ 25 / 10 ~ 30 / 20 ~ 55 (合計 100 %)

である。

5) 乾燥後の質量が、 $10 \text{ g} / \text{m}^2$ になるようにフィルムにコーティングしたヒートシール性樹脂組成物が、

0 ~ - 30 環境下でヒートシール強度 (J I S K 6854 - 3 に準拠) が 1.0 N / 15 mm 以上である。

【請求項 2】

有機溶剤が、脂環族炭化水素系溶剤、エステル系溶剤およびアルコール系溶剤であることを特徴とする請求項 1 記載のヒートシール性樹脂組成物。

【請求項 3】

ポリアミド樹脂 (樹脂 E) を、さらに、含有してなることを特徴とする請求項 1 または 2 記載のヒートシール性樹脂組成物。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0011】

すなわち第 1 発明は、エチレン - 酢酸ビニル共重合体 (樹脂 A)、スチレン - ブタジエン - スチレン共重合体 (樹脂 B)、芳香族系石油樹脂 (樹脂 C)、塩素化ポリオレフィン樹脂 (樹脂 D) および有機溶剤を含有するヒートシール性樹脂組成物であって、

下記 1) ~ 5) であることを特徴とするヒートシール性樹脂組成物。

1) エチレン - 酢酸ビニル共重合体 (樹脂 A) が、

酢酸ビニル含有率 20 ~ 40 重量 %

および

メルトマスフローレート 2 ~ 500 g / 10 分

である。

2) 芳香族系石油樹脂 (樹脂 C) が、

軟化点 120 ~ 150

および

重量平均分子量 1,500 ~ 2,500

である。

3) 塩素化ポリオレフィン樹脂 (樹脂 D) が、

塩素含有率 20 ~ 40 重量 %

であり、かつ、

無水マレイン酸変性塩素化ポリオレフィン樹脂

である。

4) 樹脂 A、樹脂 B、樹脂 C および樹脂 D が、

固形分重量比率樹脂 A / 樹脂 B / 樹脂 C / 樹脂 D

= 20 ~ 50 / 15 ~ 25 / 10 ~ 30 / 20 ~ 55 (合計 100 %)

である。

5) 乾燥後の質量が、 $10 \text{ g} / \text{m}^2$ になるようにフィルムにコーティングしたヒートシール性樹脂組成物が、

0 ~ - 30 環境下での T 型剥離強度試験 (J I S K 6854 - 3 に準拠) にて 1.0 N / 15 mm 以上である。

